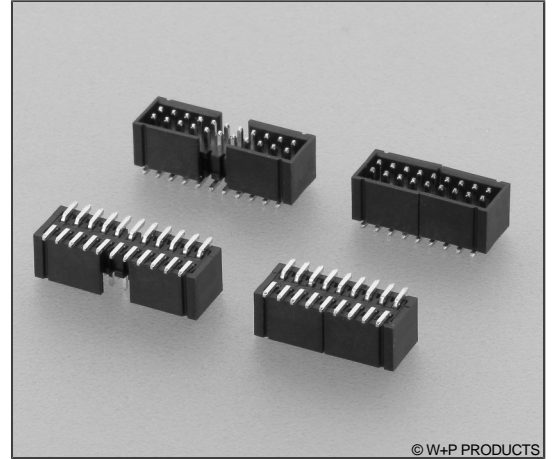


### Technische Daten / Technical Data

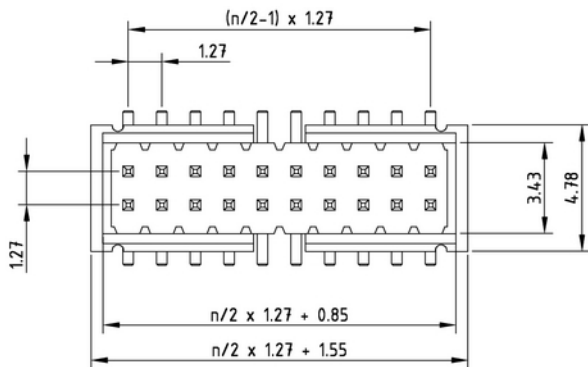
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,40mm, Kupferlegierung <i>Square pin 0.40mm, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm) <i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 500MΩ <i>&gt; 500MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500V <sub>AC</sub> <i>500V<sub>AC</sub></i>
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	125V <sub>AC</sub> <i>125V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1A <i>1A</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40°C ... +105°C <i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



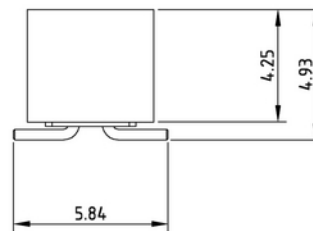
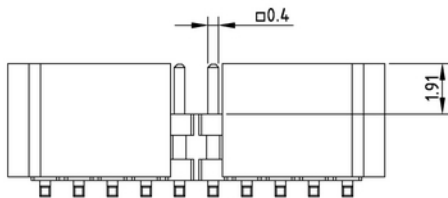
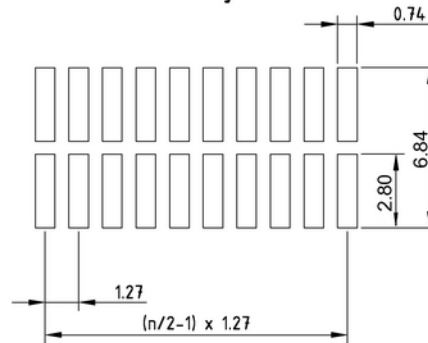
© W+P PRODUCTS

Passende Gegenstecker:  
Compatible Connectors:

376



### PCB Layout



#### Series

**6113**

#### Contacts\*

**024**

018-100

#### Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated  
60 Sel. Au / Sn  
Duplex plating

#### Packaging\*

**ST**

ST  
PPST  
PPTR (Option)

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

#### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads

**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / In tubes with P&P-Pads

**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

# Informationen zum Reflow-Lötverfahren

## Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung

#### Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

